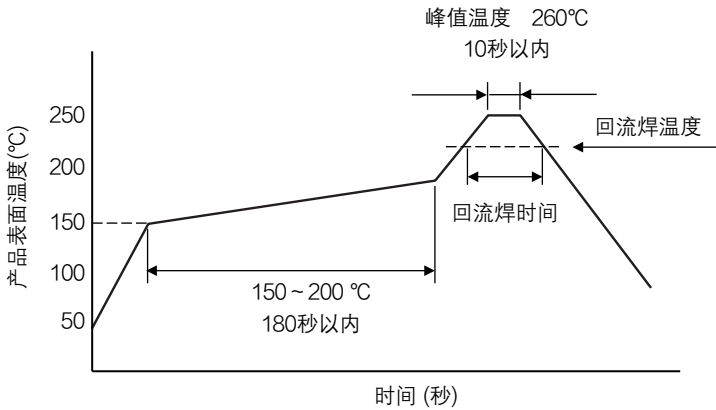


贴装规格

● 锡焊推荐条件



回流焊温度和时间

温度	时间
255°C以上	30 秒以内
230°C以上	130 秒以内
217°C以上	150 秒以内

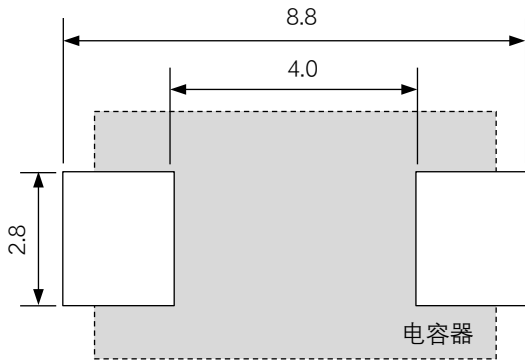
回流焊满足
IPC/J-STD-020D 符合

回流焊在下列回流焊条件下至多3次。

● 参考焊盘尺寸

□ 2端子产品

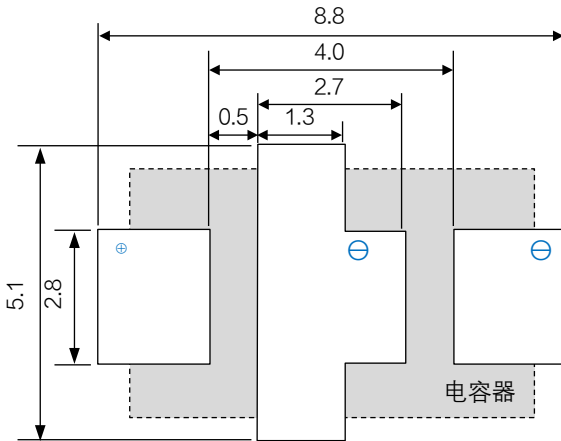
标准端子形状用 (C*, S*, G*, J*, K*, T*, HX 系列)



单位:mm

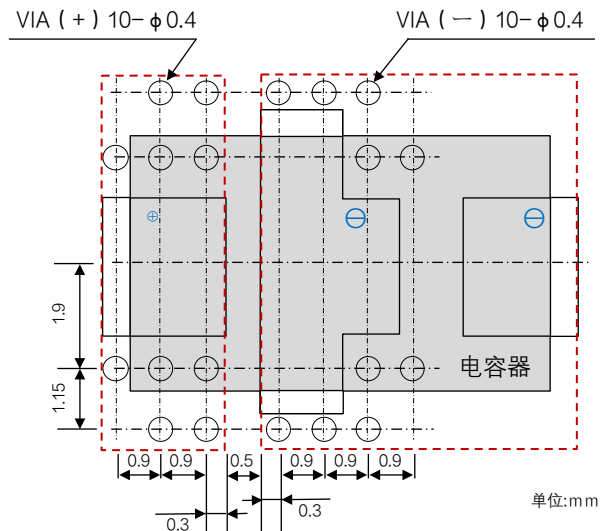
□ 3端子产品

用于低ESL端子形状 (L*, GX-L 系列)



〈VIA盘尺寸〉

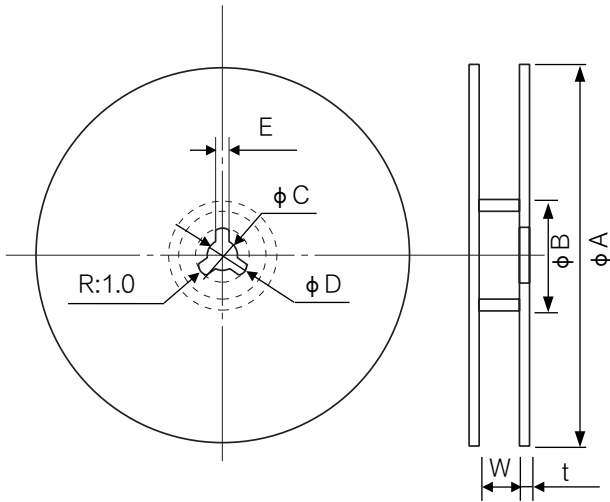
用于低ESL端子形状 (L*, GX-L 系列)



单位:mm

包装规格

● 带状包装用卷盘

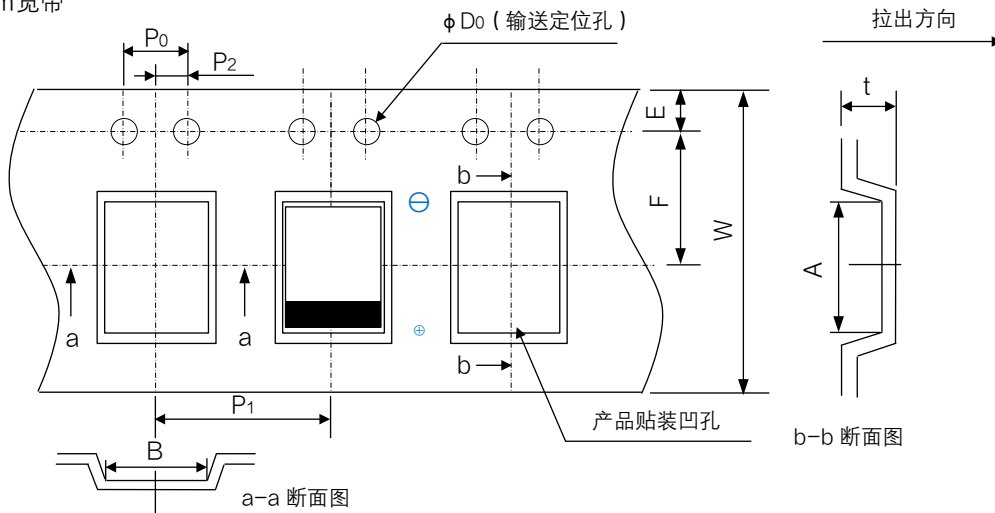


单位:mm

卷盘	φA	φB	φC	φD	E	W	t
φ 330	330	80	13±0.5	21±0.8	2±0.5	14	3
φ 180	180	60	13±0.5	21±0.8	2±0.5	14	3

● 模压带包装

12mm宽带

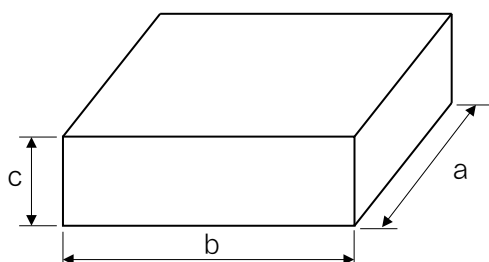


单位:mm

A	B	W	F	E	P1	P2	P0
7.6±0.2	4.5±0.2	12±0.3	5.5±0.1	1.75±0.1	8.0±0.1	2.0±0.1	4.0±0.1

φ Do	上行: 产品高度(mm) / 下行: t			
	~ 1.1	1.4 ~ 1.9	2.2	2.8
1.5 ^{+0.1} / ₀	1.5±0.2	2.4±0.2	2.9±0.2	3.5±0.2

● 包装箱外观尺寸



单位:mm

卷盘	a	b	c
φ 330	400 max.	400 max.	135 max.
φ 180	320 max.	240 max.	135 max.